

Title (en)  
Shielded multipole printed circuit connector

Title (de)  
Geschirmter, hochpoliger Leiterplattensteckverbinder

Title (fr)  
Connecteur multipôle, blindé, pour circuit imprimé

Publication  
**EP 1672744 A2 20060621 (DE)**

Application  
**EP 05025857 A 20051126**

Priority  
DE 102004060782 A 20041217

Abstract (en)  
The connector has a metallic housing (3) in which disk-shaped segments are arranged in parallel, and an insulating body. The metallic housing includes a mass contact section. Electrical contacts (15) are arranged within the disk-shaped segments. The electrical contacts are provided with plugging and connecting sides (7, 8). The disk-shaped segments are formed as mass segment or signal segment (11).

Abstract (de)  
Zur Übertragung von Signalen von einer Leiterplatte auf eine weitere Leiterplatte wird ein geschirmter, hochpoliger Leiterplattensteckverbinder (1) vorgeschlagen, der aus einem metallischen Steckverbindergehäuse (3) gebildet ist, in dem mehrere nebeneinander angeordnete Segmente (10,11,12,13) mit darin gehaltenen elektrischen Kontakten (15) vorgesehen sind. Mittels einer entsprechenden Anordnung der Kontakte innerhalb der Segmente und des Steckergehäuses ist eine Reduzierung der Kontaktierungen von der Steckseite zur Anschlussseite des Leiterplattensteckverbinders realisierbar.

IPC 8 full level  
**H01R 12/71** (2011.01); **H01R 13/658** (2011.01); **H01R 13/6581** (2011.01); **H01R 13/6471** (2011.01); **H01R 13/6587** (2011.01)

CPC (source: EP US)  
**H01R 13/6471** (2013.01 - EP US); **H01R 13/6587** (2013.01 - EP US); **H01R 12/73** (2013.01 - EP US); **H01R 13/514** (2013.01 - EP US); **H01R 13/518** (2013.01 - EP US)

Cited by  
DE102014117233A1; WO2016083079A1

Designated contracting state (EPC)  
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)  
AL BA HR MK YU

DOCDB simple family (publication)  
**DE 102004060782 B3 20060309**; CN 100566031 C 20091202; CN 1790814 A 20060621; DK 1672744 T3 20130506; EP 1672744 A2 20060621; EP 1672744 A3 20120222; EP 1672744 B1 20130206; ES 2404936 T3 20130529; JP 2006173130 A 20060629; JP 4813892 B2 20111109; PL 1672744 T3 20130731; US 2006134987 A1 20060622; US 7101225 B2 20060905

DOCDB simple family (application)  
**DE 102004060782 A 20041217**; CN 200510129687 A 20051216; DK 05025857 T 20051126; EP 05025857 A 20051126; ES 05025857 T 20051126; JP 2005363558 A 20051216; PL 05025857 T 20051126; US 28059805 A 20051116